



Management Performance
Q2 2023



4차 산업혁명을 선도하는
반도체용 PCB 제조 전문기업



Disclaimer

본 자료는 투자자의 투자판단을 돕기 위한 참고자료로 작성된 자료입니다.

당사는 2019년 1월 1일을 K-IFRS 전환일로 하였습니다. 2019년(제9기)과 2018년(제8기) K-IFRS 재무제표는 감사를 받지 아니하였으나, 비교가능성을 위해 K-IFRS 기준으로 기재하였습니다. 다만, 2019년(제9기)과 2018년(제8기) K-GAAP 재무제표에 대해서는 적정의견을 수령하였습니다.

자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 회사가 발생하는 증권의 모집 또는 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며, 문서의 어떠한 내용도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없습니다.

Head Office & Factory

회 사 명 | (주)티엘비

설 립 일 | 2011년 3월 25일

사업분야 | PCB 제조업

직 원 수 | 445명

주 소 | 경기도 안산시 신원로 305

매 출 액 | 2,215억 (2022年)

공 장 | 20,680㎡

Land 130m x 70m

Building 100m x 60m

▷ USA Office
17870 Sky Park Cir, #257, Irvine, CA 92614

▷ China Office
苏州工业园区玲珑湾6幢805

▷ Vietnam Office
Lot, CN8-4, Yen Phong II-C Industrial
Zone, Cho Town, Yen Phong District,
Bac Ninh Province, Vietnam.



고다층(High-Multilayer), 고밀도(Fine-Pitch), 고성능 (Build-up) 기술 기반 Top Tier PCB 제조 기업

Server
DDR5

Enterprise
SSD

Top Tier
메모리반도체 PCB 기업



반도체 장비용
PCB

World Class
300

기업 규모 · 시장건전성 · 재무요건 ALL - Pass

KOSDAQ 코스닥상장법인

 티엘비

코스닥 상장 기업 1,632社 中 29%

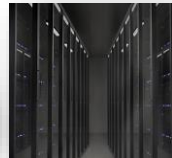
지속적인 차세대 제품 개발·선점 Line-Up을 통한 고부가가치 사업 확장



데스크톱 PC용



노트북 · PC용



서버용



차세대 제품

Memory Module PCB (DDR5)



U-DIMM
(Unbuffered DIMM)

DDR4



So-DIMM
(Small Outline DIMM)



★R-DIMM
(Registered DIMM)



DDR5
U-DIMM So-DIMM **★R-DIMM**

SSD Module PCB



2.5인치



Gumstick



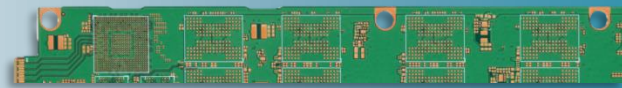
M.2



★E1.S

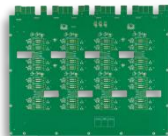


★E3



★ Enterprise & Data Center용 PCB (E1.L)
고밀도 · 고성능 · 열효율 최적의 SSD Module PCB

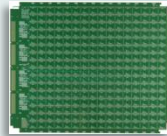
신규 아이템



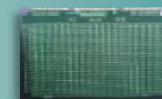
LOAD BOARD
(Back Plain Board)



HI-FIX BOARD
(Socket Board)



BIB-IN BOARD



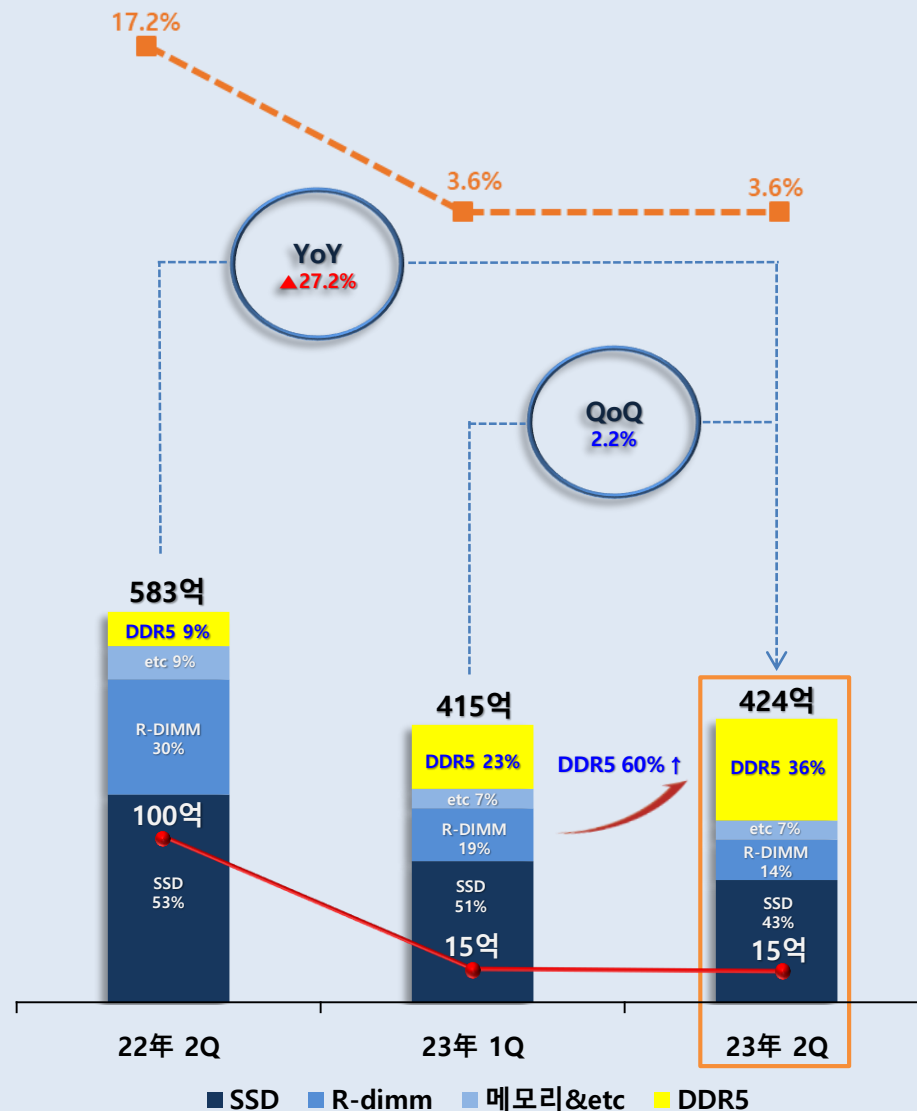
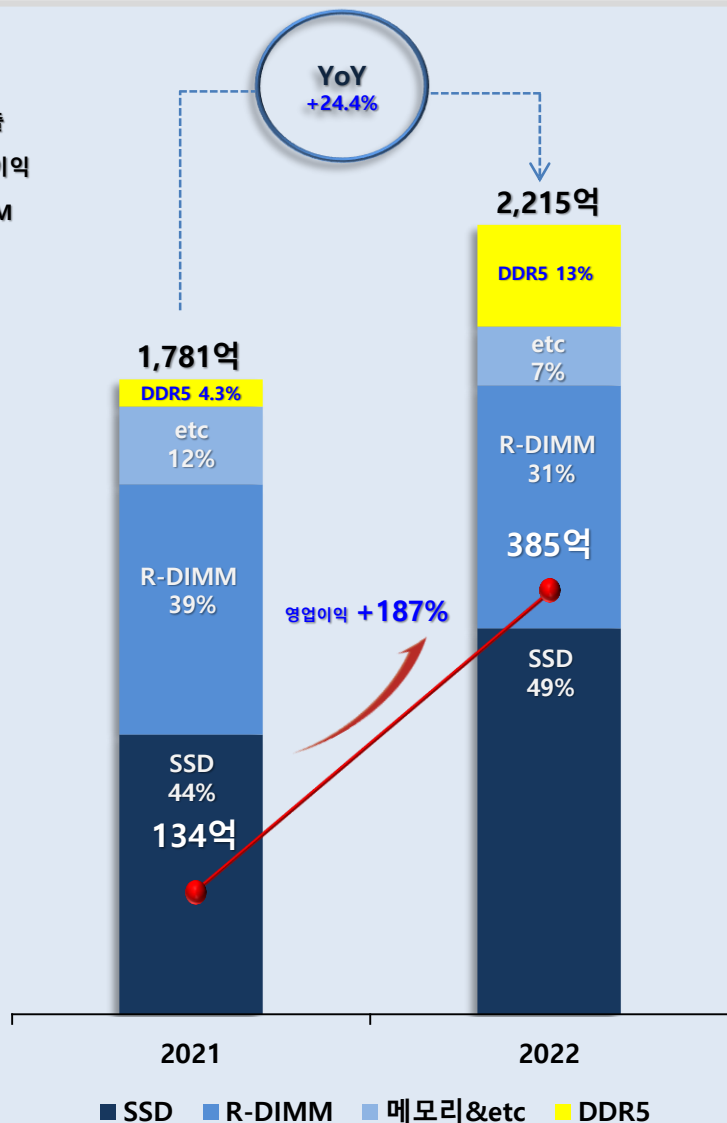
반도체 테스트 장비용 PCB
반도체 후공정 PCB

'23년 경영 성과 - ① Q2 실적

- 매출: 23년 Q2 QoQ +2.2% ↑ → 경기 침체 및 글로벌 반도체 산업 업황 부진 대비 매출 견조, **DDR5 60% ↑**, 지속 증가로 업황 개선 및 세대 교체 기대감 확대
- 영업이익: 23년 Q2 영업이익 **15억** → 글로벌 경기 침체발 반도체 수요 부진 間 개발 선점 및 초원가혁신 비상 경영 시행으로 **Q2 OPM 3.6%** 흑자 유지

단위: 억원

- 매출
- 영업이익
- OPM



재무상태표

단위: 억원

구분	2021	2022	2023 Q1	2023 Q2
자산총계	1,250	1,649	1,650	1,592
유동자산	544	783	736	639
비유동자산	705	866	914	953
부채총계	418	526	534	476
유동부채	280	286	300	298
비유동부채	137	240	234	178
자본총계	832	1,123	1,115	1,116
자본금	25	49	49	49

손익계산서

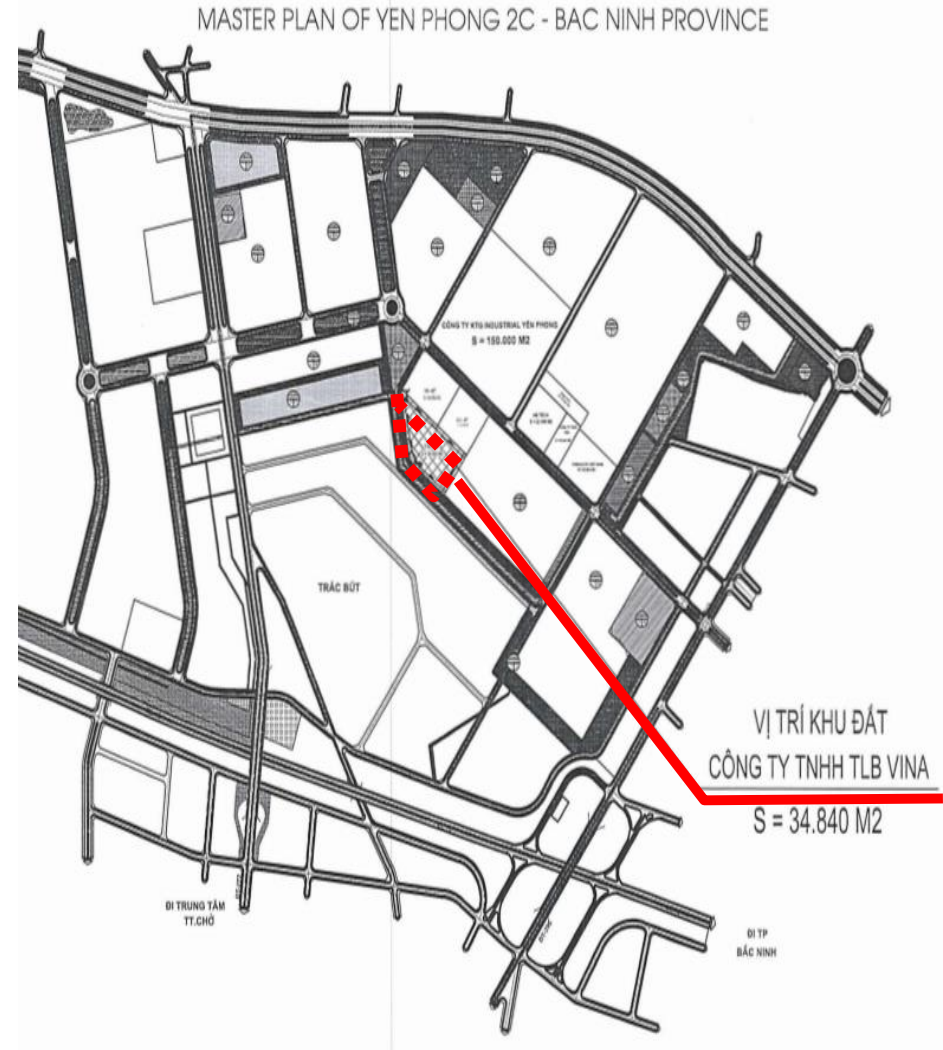
단위: 억원

구분	2021	2022	2023 Q1	2023 Q2
매출액	1,781	2,215	415	424
매출원가	1,550	1,746	380	389
매출총이익	231	469	35	35
판매비와관리비	97	85	19	20
영업이익	134	385	15	15
금융수익	3	5	4	2
금융비용	3	9	3	3
기타수익	26	41	12	5
기타비용	10	39	6	3
법인세차감전순이익	149	382	23	15
법인세비용	25	77	5	3
당기순이익	124	306	18	12

안산 신공장 부지 확보 및 기존 공장 철거 完 → 생산 능력 및 수익성 up ↑



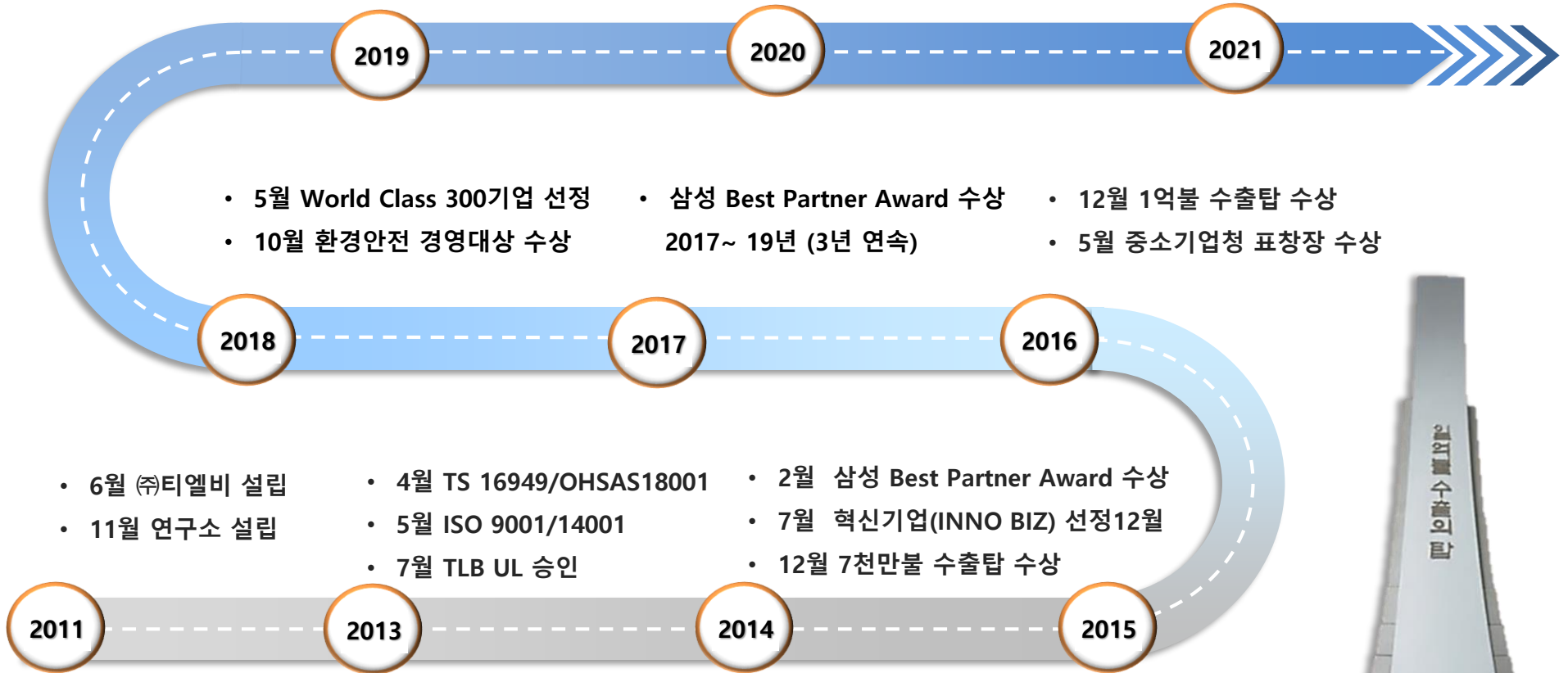
TLB VINA 법인 설립 및 34,840m² 부지 확보 → 글로벌 거점으로, 본격 현지 대응

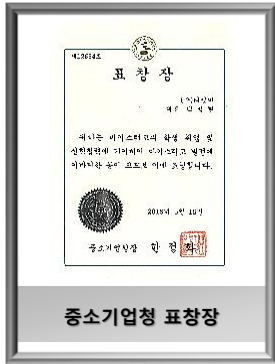


TLB VINA 2023년 완공 임박 → 글로벌 공급망 기반 구축



- 4월 SK Hynix 동반성장 협의회 가입
- 7월 대한적십자사 유공자 금장 포상
- 혁신기업 국가대표 1000선정
- 10월 안전경영대상 최우수상 수상
- 12월 티엘비 코스닥 상장
- 선도형 디지털 클러스터 선정
- Sk하이닉스 동반성장 부문 대상
- 베트남 해외 법인 설립

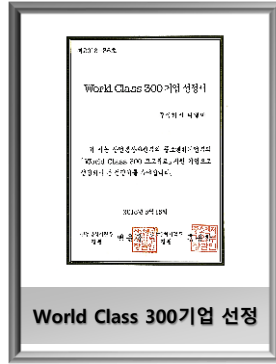




중소기업청 표창장



테스트 보드와 반도체 칩
매개장치 특허 외 다수



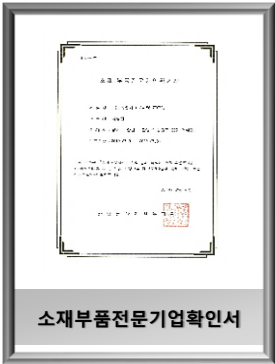
World Class 300+기업 선정



삼성전자(주) DS부문
우수협력사



제53회 무역의날 포상(1억불)



소재부품전문기업확인서



IATF16949-2016 적합성



KS Q ISO 45001 : 2018



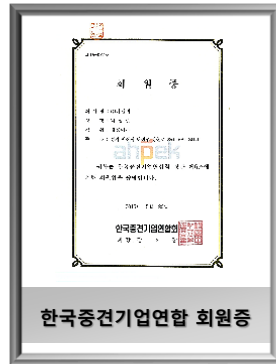
KS Q ISO 9001 : 2015



KS Q ISO 14001 : 2015



KPCA 회원증



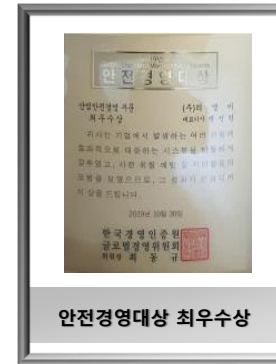
한국중견기업연합 회원증



대한적십자사 포상



한국마이크로전자패키징
연구조합 감사장



안전경영대상 최우수상





Thank you